

证券代码：688809

证券简称：强一股份

公告编号：2026-051

强一半导体（苏州）股份有限公司

关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **超额募集资金金额及使用用途：**拟使用全部超额募集资金（以下简称“超募资金”）合计人民币 102,672.51 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）用于在建项目：（1）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）南通探针卡研发及生产项目；（2）强一半导体探针卡制造基地项目，并等额减少原先预计投入的自有及自筹资金金额。

● **募投项目延期情况：**南通探针卡研发及生产项目的达到预定可使用状态日期由 2026 年 11 月延期至 2027 年 12 月，延期末改变项目的内容、投资总额、实施主体，项目实施的可行性未发生重大变化，不会对公司募投项目的实施造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

● **已履行的审议程序：**2026 年 7 月 24 日，强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“强一股份”）召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》。公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，该事项尚需

提交公司股东会审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币2,756,055,059.38元，扣除发行费用人民币229,593,251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,526,461,807.97元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月25日出具的《强一半导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。公司及实施募投项目的子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通强一”）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金总额	275,605.51 万元
募集资金净额	252,646.18 万元
超募资金金额	102,646.18 万元
募集资金到账时间	2025 年 12 月 25 日

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

根据公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）、《关于增加部分募投项目实施地点、实施主体及开立募集资金专户的公告》（公

告编号：2026-041），公司调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金	实施主体
1	南通探针卡研发及生产项目	246,770.00	120,000.00	南通强一、公司
2	苏州总部及研发中心建设项目	44,248.50	30,000.00	公司
合计		291,018.50	150,000.00	

注：1、公司于2026年1月22日召开第二届董事会第六次会议、于2026年2月9日召开公司2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司南通强一使用自有资金及自筹资金分别增加募投项目南通探针卡研发及生产项目和苏州总部及研发中心建设项目的投资额度并调整其内部投资结构，调整后项目投资总额合计由150,000.00万元增加至291,018.50万元。

2、公司于2026年6月2日召开第二届董事会战略委员会第三次会议、第二届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点、实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意新增强一股份作为南通探针卡研发及生产项目的实施主体。

（二）超募资金使用情况

公司2025年首次公开发行股票实际募集资金净额252,646.18万元，其中超募资金102,646.18万元。截至2026年6月30日，公司超募资金使用和余额情况具体如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	超募资金可使用金额①	102,646.18
2	利息收入②	26.33
3	剩余超募资金金额③=①+②	102,672.51

三、超募资金使用安排

为优化公司流动资金使用效率，保障募投项目顺利推进，本次计划使用全部超募资金（含利息收入）投入南通探针卡研发及生产项目及强一半导体探针卡制造基地项目，并等额减少原先预计投入两个项目的自有及自筹资金金额，剩余的部分使用公司（含子公司）自有及自筹资金补足。本次使用超募资金投资在建项

目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次计划不调整两个生产项目的总投资额及建设内容，仅对资金来源结构进行调整。具体情况如下：

超募资金金额(含利息收入)	102,672.51 万元（实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）
前次已使用金额	0.00 万元
本次使用用途及金额	☒ 在建项目 1、项目一名称：南通探针卡研发及生产项目（以下简称“项目一”），87,672.51 万元（全部超募资金存储期间产生的全部利息收入及部分超募资金本金金额 87,646.18 万元，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准） 2、项目二名称：强一半导体探针卡制造基地项目（以下简称“项目二”），15,000 万元

（一）项目一具体情况

1、基本情况

项目名称	南通探针卡研发及生产项目
实施主体	南通强一、强一股份
实施地点	江苏省南通市苏锡通科技产业园区、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区金桥临港智荟园一期 4 幢 1-2 层、江苏省苏州市苏州工业园区长阳街 107 号 S9 栋
项目内容	通过新建生产用房及相关配套设施，引进光刻机、电镀设备、匀胶显影机等先进生产设备，进行 2D MEMS 探针卡、2.5D MEMS 探针卡及薄膜探针卡的产能建设
项目总投资金额	人民币 246,770.00 万元
达到预定可使用状态时间	2027 年 12 月

2、投资计划

公司拟投入项目一的募集资金合计人民币 207,672.51 万元，其中超募资金 87,672.51 万元（含超募资金存储期间产生的利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准），公司将通过向子公司南通强一借款或增资的方式将超募资金分配给南通强一以实施募投项目，并等额减少原先预计投入本项目的自有及自筹资金金额，剩余缺口部分拟使用公司自有或自筹资金。投资计划具体如

下：

单位：万元

具体安排	投资总额	资金来源结构 调整前		资金来源结构 调整后	
		原计划使用 募集资金投 资金额	拟使用自有资 金或自筹资金 投资金额	拟使用募集资 金投资金额 (含超募资 金)	拟使用自有资 金或自筹资金 投资金额
土地投资	2,235.00	2,235.00	-	2,235.00	-
建设投资	39,481.00	35,404.00	4,077.00	35,404.00	4,077.00
设备投资	182,554.00	65,861.00	116,693.00	153,533.51	29,020.49
预备费	11,100.00	5,100.00	6,000.00	5,100.00	6,000.00
铺底流动资金	11,400.00	11,400.00	-	11,400.00	-
总投资金额	246,770.00	120,000.00	126,770.00	207,672.51	39,097.49

注：上表中拟使用募集资金投资金额含超募资金存储期间产生的利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准。

（二）项目二具体情况

1、基本情况

项目名称	强一半导体探针卡制造基地项目
实施主体	强一半导体（合肥）有限公司（以下简称“合肥强一”）及公司未来在经开区新设立一家或多家独立核算、自负盈亏的法人单位（或有）共同作为项目实施主体
实施地点	合肥经济技术开发区综合保税区云谷路以北综保大道以西
项目内容	通过建设综合楼、生产厂房及相关配套辅助设施，购置各类机台、清洗机、调针剂、理针机等生产设备，进行集成电路晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售
项目总投资金额	人民币 112,280.61 万元
达到预定可使用状态时间	2027 年 5 月

注：项目二具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>暨终止原投资协议的公告》（公告编号：2026-017）。

2、可行性与必要性

当前，全球半导体产业正处于新一轮技术升级与需求扩张的关键周期，5G 通信、人工智能、高性能计算及汽车电子等下游应用的快速发展，不断推高芯片的集成度与测试复杂度。探针卡作为晶圆测试中的关键接口部件，其性能与产能直接关系到芯片良率和量产效率。其中，悬臂探针卡凭借成熟的工艺和稳定的成本优势，在主流存储领域及非存储领域芯片中均有应用；而 2.5D MEMS 探针卡因在 Chiplet 架构与 HBM 三维堆叠等先进封装测试中的不可替代性，已成为当前半导体晶圆测试产业链中核心的技术竞争焦点。与此同时，国内高端探针卡自主供给率仍然偏低，尤其是在微间距、高针数、长寿命等关键指标上与国际先进水平存在差距，亟需建设具备规模化、精密化生产能力的新型制造基地，以保障本土半导体供应链的韧性与安全。

公司投资建设强一半导体探针卡制造基地项目，是作为响应产业需求的重要举措。本项目建成达产后预计将形成年产 2.5D MEMS 探针卡 12,000 万根针、悬臂探针卡 180 万根针的生产能力，既覆盖了基础测试需求，又瞄准了高端增量市场，产品定位清晰，市场前景广阔。

3、投资计划

公司拟使用人民币 15,000.00 万元的超募资金对合肥强一进行增资以实施项目，并等额减少原先预计投入本项目的自有及自筹资金金额，剩余缺口部分拟使用公司及合肥强一的自有或自筹资金。投资计划具体如下：

单位：万元

具体安排	投资总额	资金来源结构 调整前	资金来源结构 调整后	
		拟使用自有资金或自筹资金投资金额	拟使用超募资金 投资金额	拟使用自有资金或自筹资金投资金额
建设投资	55,117.93	55,117.93	9,000.00	46,117.93
建设期利息	376.43	376.43	-	376.43
流动资金	5,786.25	5,786.25	-	5,786.25
研发投入	51,000.00	51,000.00	6,000.00	45,000.00
总投资金额	112,280.61	112,280.61	15,000.00	97,280.61

本次增资完成后，合肥强一的注册资本将由 40,500.00 万元增加至 55,500.00 万元，仍为公司全资子公司。公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权办理上述增资事项的后续工作。增资对象基本情况如下：

公司名称	强一半导体（合肥）有限公司	
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	
统一社会信用代码	91340111MA8P07EY0C	
法定代表人	周明	
成立日期	2022 年 4 月 29 日	
注册资本	40,500 万元	
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区青龙潭路集成电路科技园 C3 栋一层北区和二层北区	
经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；光电子器件制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料制造；特种陶瓷制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
最近两年主要财务数据（单位：万元）：		
科目	2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	23,183.57	10,467.32
负债总额	6,962.26	4,339.65
所有者权益总额	16,221.31	6,127.68
资产负债率	30.03%	41.46%
科目	2025 年度 （经审计）	2024 年度 （经审计）
营业收入	5,409.60	4,461.08
净利润	-1,406.37	-421.22

注：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入所致。

4、项目的经济效益

本项目的实施，符合国家加强半导体产业链的自主可控的一系列产业政策，项目产品在国内外具有较大的市场需求，有望提高公司的经营规模以及盈利水平，

预计将对公司的利润产生积极影响。

（三）开立募集资金专户事宜

本次使用超募资金投资在建项目的相关审批程序履行完成后，南通强一与合肥强一将分别开立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金，董事会授权公司管理层或其授权人员办理开立募集资金专用账户、与保荐人和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

本次开立手续等事项办理完毕后，公司及实施主体将根据本项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述拟投入超募资金的限额下，将上述款项划转至其新开立的募集资金专户中。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、本次部分募投项目延期的情况

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

截至 2026 年 6 月 30 日，南通探针卡研发及生产项目投入进度如下：

单位：万元

项目	拟投入募集资金金额（不含超募资金）	已投入募集资金金额	已投入募集资金进度
南通探针卡研发及生产项目	120,000.00	53,218.64	44.35%

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
南通探针卡研发及生产项目	2026 年 11 月	2027 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

随着高端存储、算力芯片等领域对测试精度和可靠性要求不断提高，下游客户对探针卡产品提出了更高要求。基于对产品品质稳定性、生产一致性及运营效率的综合考量，公司对原规划的手动及半自动生产线方案进行了系统性升级，拟建设以全自动化生产设备为核心的先进制造体系。经综合考虑当前市场需求、现有产能、募集资金使用效率等情况，基于审慎性原则，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月。除上述募投项目延期原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求，密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况，积极协调公司内外部资源配置，保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用的风险，推动募投项目按期完成。

五、本次事项对公司的影响及风险

（一）本次使用超募资金对公司的影响

本次使用超募资金投入在建项目，未改变在建项目的投资总额、建设内容、实施主体等，项目可行性未发生重大变化，仅对项目资金来源结构进行调整，目的是加快公司在建项目建设进度，保障项目资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变原募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（二）本次使用超募资金产生的风险

1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、公司使用超募资金投资在建项目是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出的审慎考虑。使用超募资金投资两个在建项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

3、本次拟使用部分超募资金投资全资子公司以建设项目，存在持续投入的过程，新增人员、折旧及摊销等费用可能导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩可能产生一定影响。

（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、适用的审议程序及保荐人意见

（一）审计委员会审议情况

2026年7月24日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》。公司本次使用超募资金投资在建项目以及将部分募投项目延期，是综合考虑了当前公司各项投资需求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素做出的审慎决定，符合公司战略规划和发展布局。上述事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

2026年7月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐人对公司本次使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年7月25日